

## 电子行业周报（6.10-6.16）

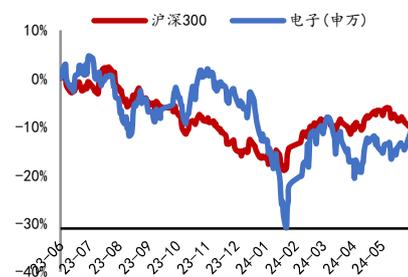
### 关注晶圆厂稼动率提升及 IC 涨价

### 强于大市（维持评级）

#### 投资要点：

- ▶ **2024年第一季度以来，各大晶圆厂的产能利用率正逐步修复，半导体行业景气度日渐回温。**其中，中芯国际和华虹的产能利用率在分别经历两、三个季度的下滑后，于24Q1实现环比提升。中芯国际管理层表示，24Q1全球客户备货意愿有所上升，且提前拉货需求还将延续。进入二季度末，晶圆厂稼动率继续攀升，据科创板日报报道，24Q2以来，在AI算力及多家大厂急单的推动下，出现量大且覆盖面广的产品需求，致使头部晶圆厂已出现产能紧张的状况。据公开资料显示，华虹半导体的晶圆厂利用率已超过100%，因此可能会在下半年将晶圆价格提高10%。年初至今，各大晶圆厂产能利用率回暖趋势较为明显，反应终端需求正稳步复苏。
- ▶ **除此之外，在产能紧张和需求回暖的推动下，各类芯片的价格也开始呈现修复态势，**涵盖主流存储器、利基存储芯片、部分模拟器件、功率器件以及电源管理等品类。近期，多家国产芯片厂商开始相继宣布涨价，涨幅最高达到了20%。例如，浙江亚芯微、南京智凌芯、深圳创芯微等多家国产芯片原厂发布涨价函，其涨价理由多归于原材料价格上涨，这直接反映了IC设计厂商对于上游半导体制造订单需求的增长，同时其背后反映的是市场需求的修复。从存储板块来看，据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%，NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。结合晶圆厂稼动率的逐级提升和当前消费电子等领域备货意愿的上升，我们能看到终端需求对半导体产业链各环节的明确传导，因此我们判断IC涨价趋势或将继续延续，而半导体行业有望迎来增长周期。
- ▶ **投资建议：**关注半导体晶圆制造环节，**华虹公司、中芯国际**；半导体封测环节，**长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技**；储存板块，**佰维存储、江波龙、兆易创新**；SoC芯片，**瑞芯微、全志科技、北京君正、晶晨股份**等。
- ▶ **风险提示：**技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。

#### 一年内行业相对大盘走势



#### 电子行业估值 (PE)



#### 团队成员

分析师 杨钟  
 执业证书编号：S0210522110003  
 邮箱：yz3979@hfzq.com.cn  
  
 联系人 詹小瑁  
 邮箱：zxm30169@hfzq.com.cn

#### 相关报告

- 《WWDC2024 即将揭幕，关注 AI 终端创新机遇》——2024.06.10
- 《AI 终端崭露头角，Mini LED 或迎机遇》——2024.06.01
- 《AI 需求助力，扇出型面板级封装迎来机遇》——2024.05.27

## 正文目录

一、	本周市场表现.....	3
1.1	电子板块本周表现.....	3
1.2	SW 电子个股本周表现 .....	3
1.3	电子板块估值分析.....	4
二、	行业动态跟踪.....	6
2.1	半导体板块.....	6
2.2	AI 板块.....	6
2.3	消费电子板块.....	10
2.4	汽车电子板块.....	10
2.5	面板板块.....	12
三、	公司动态跟踪.....	13
四、	风险提示.....	15

## 图表目录

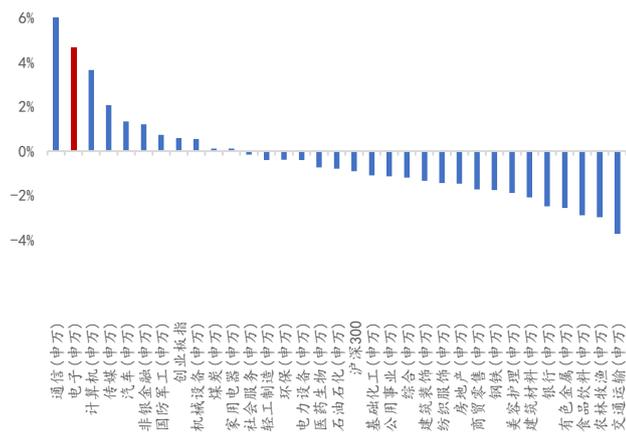
图表 1:	SW 各行业板块本周市场表现.....	3
图表 2:	电子板块成交额及日涨跌幅.....	3
图表 3:	电子细分领域本周涨跌幅 (%) .....	3
图表 4:	SW 电子本周涨幅前十个股 (%) .....	3
图表 5:	SW 电子本周跌幅前十个股 (%) .....	3
图表 6:	SW 电子本周换手率前二十个股 (%) .....	4
图表 7:	SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM) .....	5
图表 8:	SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM) .....	5
图表 9:	过去一周股东增减持更新 .....	13
图表 10:	过去一周股权激励一览.....	14

## 一、 本周市场表现

### 1.1 电子板块本周表现

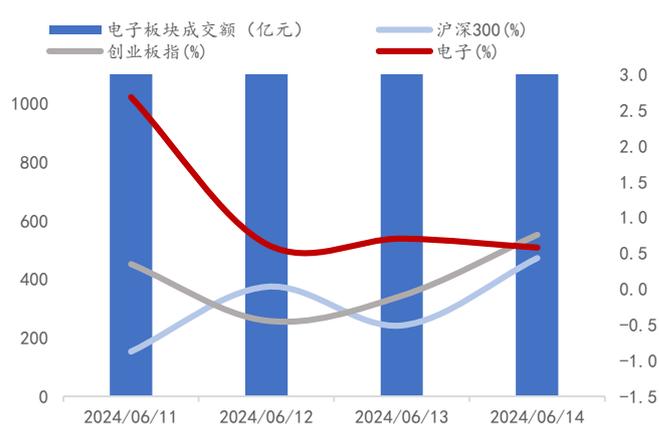
大盘表现上，本周（0611-0614）创业板指数上涨 0.58%，沪深 300 指数下降 0.91%。本周电子行业指数上涨 4.67%。行业表现上，电子行业涨跌幅位列全行业的第 2 位，除电子板块外，本周通信、计算机、传媒板块涨跌幅位居前列。

图表 1：SW 各行业板块本周市场表现



数据来源：Wind，华福证券研究所

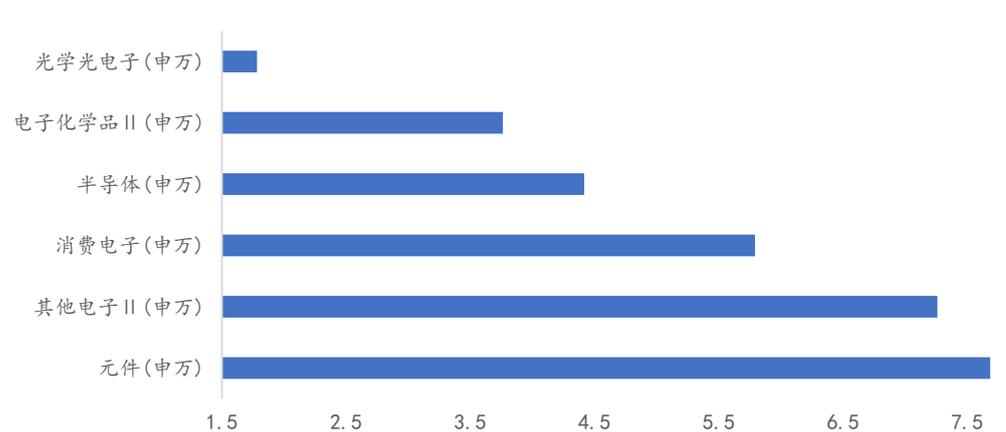
图表 2：电子板块成交额及日涨跌幅



数据来源：Wind，华福证券研究所

从电子细分行业指数看，本周所有电子细分板块均有所上涨。具体来看，元件板块领涨，周涨跌幅为+7.68%。

图表 3：电子细分领域本周涨跌幅（%）



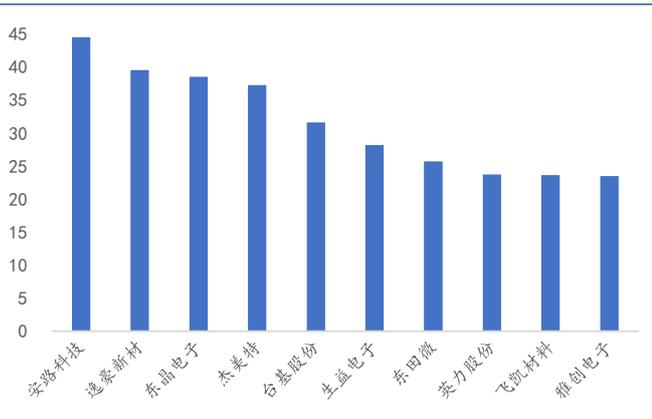
数据来源：Wind，华福证券研究所

### 1.2 SW 电子个股本周表现

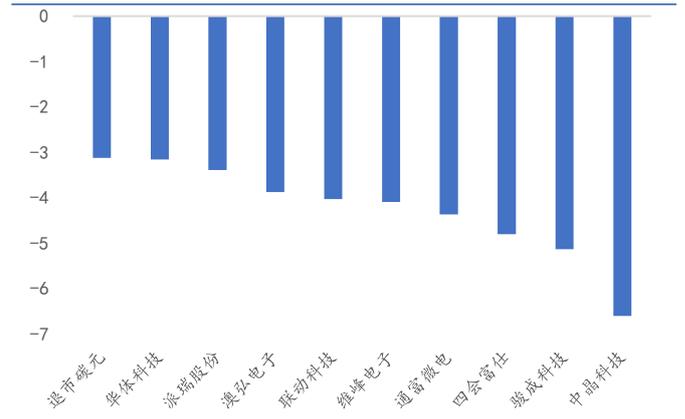
从个股维度来看，SW 电子板块中，安路科技（44.46%）、逸豪新材（39.51%）等位列涨幅前列；中晶科技（-6.60%）、骏成科技（-5.14%）等位列跌幅前列。

图表 4：SW 电子本周涨幅前十个股（%）

图表 5：SW 电子本周跌幅前十个股（%）



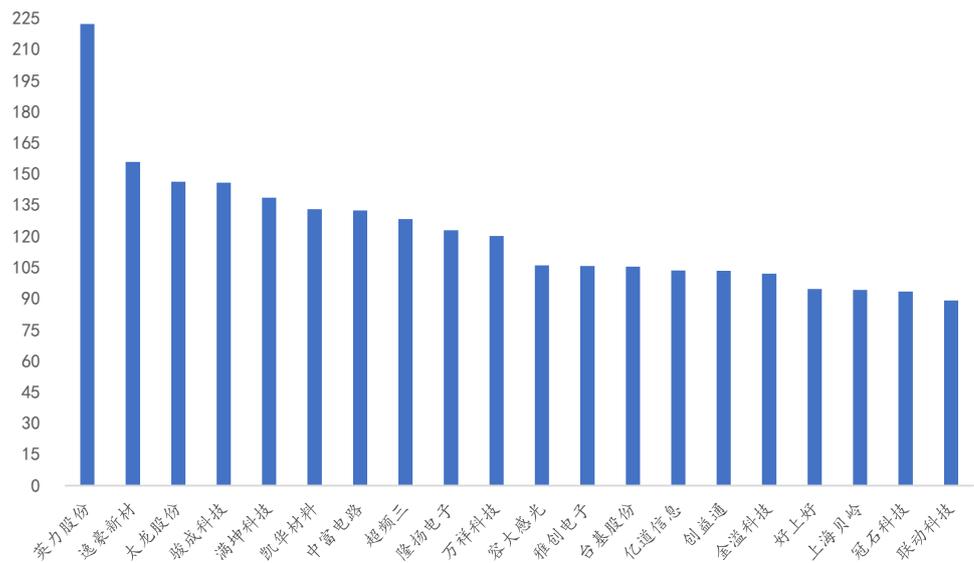
数据来源: Wind, 华福证券研究所



数据来源: Wind, 华福证券研究所

从换手率来看,本周电子行业个股换手率最高的是英力股份,换手率为191.03%。其余换手率较高的还有逸豪新材(185.20%)、台基股份(122.68%)和雅创电子(121.68%)。

图表 6: SW 电子本周换手率前二十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

### 1.3 电子板块估值分析

从本周 PE 走势来看,整体电子行业估值高于近一年、三年、五年平均值水平。本周 PE (TTM) 为 55.56 倍,较上周有所上涨。

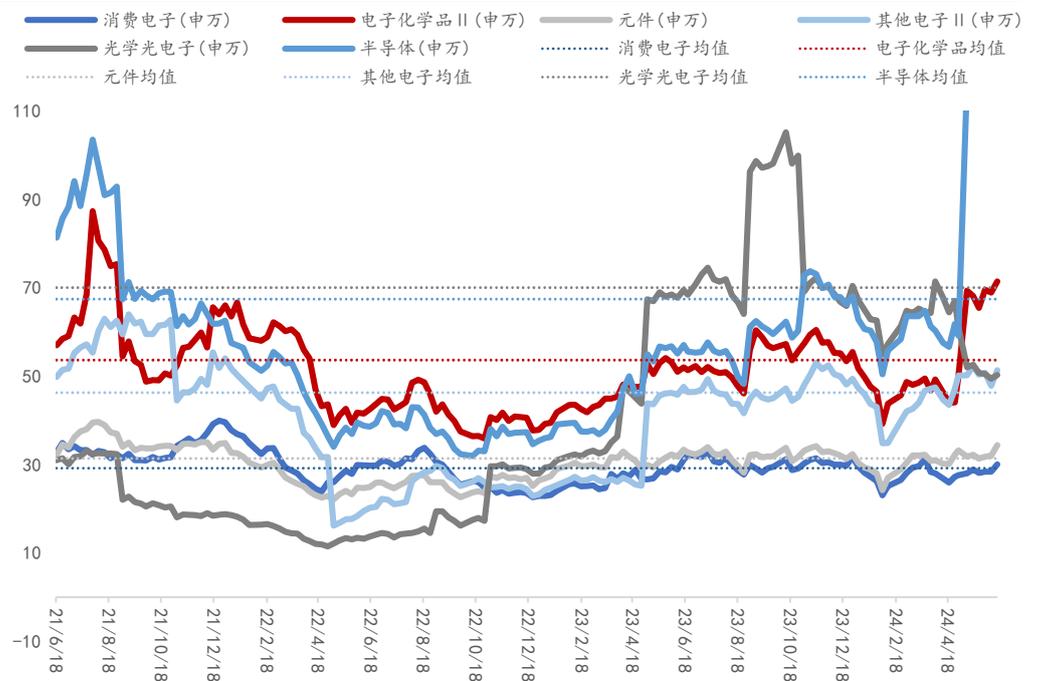
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

细分领域上, 本周消费电子、电子化学品、元件、其他电子、光学光电子和半导体板块 PE 分别为 30.02、71.43、34.35、51.36、50.26 和 123.93, 本周电子细分板块估值均有一定程度上涨。

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

## 二、 行业动态跟踪

### 2.1 半导体板块

#### 1) Q1 DRAM 产业营收环比增长 5%至 183.5 亿美元

市场研究机构 TrendForce（集邦咨询）的调查显示，2024 年第一季度，受到主流产品合约价增长，且涨幅较 2023 年第四季度扩大，带动 DRAM 产业营收较 2023 年第四季度增长 5.1%至 183.5 亿美元，推动多数厂商营收呈季增趋势。

TrendForce 指出，第一季度三星、SK 海力士及美光三大原厂出货皆出现季减，反映产业淡季效应，加上下游厂商的库存水平高，采购量明显衰退。

营收方面，第一季度三星的营收微幅增加至 80.5 亿美元，季增幅仅 1.3%，营收市占小幅下滑 1.6 个百分点至 43.9%，仍维持排名第一；SK 海力士排名第二，第一季度营收微幅增加至 57.0 亿美元，季增幅仅 2.6%，营收市占小幅下滑 0.7 个百分点至 31.1%；美光第一季度营收增加至 39.5 亿美元，季增幅达 17.8%，营收市占上升 2.3 个百分点至 21.5%，排名第三。

#### 2) 摩根士丹利：DRAM 将迎供需失衡“超级周期”，明年标准型 DRAM 供应缺口高达 23%

摩根士丹利在新一期报告中指出，存储将出现“前所未有的”供需失衡，内存的价格也水涨船高。人工智能的快速发展将导致 DRAM 和 HBM 的供需失衡。

摩根士丹利指出，由于近年来 DRAM 厂新增产能有限，叠加 HBM 消耗大量产能，DRAM 正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”，明年标准型 DRAM 供应缺口高达 23%，将比 HBM 更缺，为近年罕见，价格将一路上涨。大摩调升今年第三季 DRAM 和 NAND 芯片价格涨幅预估，由原预期 8%和 10%，上调至 13%和 20%，调升幅度高达六成以上。

摩根士丹利预计，到 2025 年，HBM 市场份额占比将增长，整体市场供应不足将更明显：预计到 2025 年，HBM 总可寻址市场（TAM）预计将显著增长，从 2025 年的 370 亿美元增长到 2027 年的 700 亿美元，市场份额将占整个 DRAM 市场的 30%以上，混合价格将上涨 10%以上。

#### 3) 一季度全球十大晶圆代工厂，中芯国际升至第三

根据研究机构 TrendForce 集邦咨询调查，2024 年第一季度消费级终端进入传统淡季，虽然供应链偶有急单出现，但多半是个别客户库存回补行为，订单动能稍显疲软；车用、工控半导体应用需求受到压制，仅人工智能（AI）服务器在全球 GSP 巨头投入大量资本竞逐、企业建置大语言模型（LLM）风潮下异军突起。

机构统计，一季度全球前十大晶圆代工厂产值环比减少 4.3%至 292 亿美元，中芯国际超越格芯、联电（UMC）跃升至第三名；台积电仍稳居首位，营收市场份额达 61.7%。

#### 4) 中国台湾半导体产业产值今年有望突破5万亿元新台币，增幅17.7%

中国台湾机构“工研院”旗下 IEKQCM 预测团队近日表示，2024 年中国台湾半导体产业产值有望首次突破5万亿元新台币（单位下同）大关，预计可达5.1134万亿元，增长17.7%。该机构表示，这一增幅优于全球半导体增长率13.1%的预测。

机构称随着市场环境改善以及消费需求的增长，预计2024年岛内制造业产值将增长6.4%，很多受到人工智能（AI）需求驱动。对于2024年岛内半导体产业发展，工研院持乐观态度，主要因为全球通货膨胀降温、就业市场趋于稳定、消费力回升，以及产业界库存调整大致完成。

关于半导体细分领域的预测，工研院预计2024年中国台湾IC设计业将增长15.1%；IC制造业也会因为先进制程产出持续提升、DRAM价格回升，今年增长20.2%；IC封测行业则受惠于换机需求与高端封测需求增长，今年有望增长11.4%。

#### 5) 台积电进驻嘉义开始买设备 冲刺 CoWoS 先进封装

英伟达、AMD 等大厂 AI 芯片热销，先进封装产能供不应求，业界传出，台积电南科嘉义园区 CoWoS 新厂正进入环差审查阶段，即开始采购设备，希望能加快先进封装产能建置脚步，以满足客户需求。同时，南科嘉义园区原定要盖两座 CoWoS 新厂还不够用，台积电也传出派员南下勘察三厂土地。

针对上述消息，台积电昨（11）日表示，不评论市场传闻。

随着 AI 应用快速发展，芯片市场对于先进封装需求同步水涨船高。台积电为英伟达、AMD 等大厂代工 AI 芯片，先进封装产能已持续供不应求一段时间，并积极扩充相关产能，并挥军南科嘉义园区盖 CoWoS 新厂。

#### 6) 三星：16层以上 HBM 芯片需采用混合键合技术

三星在最近的一篇论文中分享，认为制造16层以上的HBM（高带宽存储）芯片需要采用混合键合（Hybrid Bonding）技术。

今年5月，在科罗拉多州举行的2024 IEEE第74届电子元件和技术会议上，三星公司发表了一篇论文，题为《用于HBM堆叠的D2W（芯片到晶圆）铜键合技术研究》。三星表示，对于HBM，16层及以上的堆叠混合键合技术是必不可少的。

#### 7) 大客户包下产能订单满到2026 台积电3纳米掀抢购潮

AI 服务器、高速运算（HPC）应用与高阶智能手机 AI 化催化半导体含矽量持续增加，苹果、高通、辉达（NVIDIA）与超微（AMD）等四大厂传大举包下台积电（2330）3奈米家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。

台积电一贯不评论单一客户讯息。至于是否会因为产能太抢手而涨价，借此「反映价值」，台积电强调「定价策略始终以策略导向，而非以机会导向，会持续与客户

紧密合作以提供价值」。

业界人士分析，台积电不是一家会随便涨价的公司，反映价值无法直接和涨价画上等号，即便该公司掌握先进制程领先优势，要对客户反映价值也有多种方式。

### 8) 中低端 CCL 产能紧缺普遍涨价 平均涨幅接近 10%

6月14日，行业分析师郭明錤发布投资简报称，由于AI PC、常规服务器以及原材料上涨等诸多因素，中低端（M4以下）印刷电路板的原料CCL已普遍涨价。

郭明錤表示，由于目前M4以下的CCL品项已普遍涨价，平均涨幅约接近10%，M4以上的高端CCL目前则没有涨价的迹象。

据笔者获悉，中低端CCL涨价主要原因是之前国内通信板报价太低，大厂逐渐放弃，近期受海外需求拉动部分产能开始紧缺，价格有些回归；加之CCL环节高速产品放量显著，国产份额有提升趋势，传统需求也在逐渐修复，困境反转可期。

从供应端看，AI服务器需求在过去一年暴增，促使CCL厂商升级产线以应付高规（M4以上）的需求，间接导致M4以下的供应减少。

从需求端看，以高通为首的AI PC，主板的材料从standard-loss升级到mid-loss，单价提升15-20%。与手机相同，高通会指定AI PC零组件/用料，目前主要采用台耀的TU 862S与联茂的IT170 GRA1。除三星外（因非常熟悉高通平台开发，有能力自行选择供应商），其余品牌（占高通AIPC出货90-95%）几乎都遵循高通的用料建议。

### 9) 美国半导体 2024 年建设支出超前 28 年总和

据国外媒体报道，随着美国《芯片与科学法案》的推动，2024年美国计算机和电气制造业的建设支出预计将达到过去28年总和的水平。

这一法案于2022年通过，旨在振兴美国半导体产业，因为美国目前在全球先进制程芯片的制造份额几乎可以忽略不计。

彼得森研究所的数据显示，自2021年起，美国计算机和电气制造业支出就已开始显著增长，而《芯片与科学法案》的530亿美元补贴更是加速了这一进程。

### 10) 5 月份我国集成电路出口金额增长 34.8%

商务部于2024年6月13日（星期四）15时召开例行新闻发布会。商务部办公厅副主任、新闻发言人何亚东出席，介绍相关情况并回答媒体提问。针对“5月中国进出口同比增长8.6%，其中出口同比增长11.2%，请问商务部如何看待当前外贸表现，对后期走势有何预期”的问题，何亚东指出：

5月当月，在一些积极因素的支撑下，中国货物贸易总体保持稳中有进的态势，表现符合预期。从行业角度来看，以下3类产品市场需求稳定：

一是消费电子类产品。在渡过周期性低谷后，电子产品逐步恢复增长，据研究机构统计，一季度手机、笔记本电脑全球出货量分别增长约 10%、4%，复苏回暖势头明显。在终端产品需求带动下，5 月中国集成电路出口、进口金额分别增长 34.8%、22%。

二是家居产品。海外主要市场去库存取得一定效果，家具、纺织服装等产品补库存动力较强，奥运会等一系列体育赛事也带动了电视机等产品的需求，5 月家电出口金额增长 23.5%。

三是部分高附加值机电产品。我国汽车、船舶依托完整产业链和技术优势，产品竞争力不断增强，5 月出口金额分别增长 20.3%、67.7%。

下半年，中国外贸发展面临的形势仍然比较复杂。主要表现在：外需增势并不稳固，主要市场补库存力度和持续性有待观察，加上地缘政治、贸易壁垒、航运价格等干扰因素增多，企业接单履约仍面临较多不确定性。我们将进一步发挥稳外贸政策的综合效能，切实帮助企业纾困解难，持续培育外贸新动能，全力推动外贸质升量稳。

#### 11) 132 亿元！沪硅产业扩产 300mm 半导体硅片

6 月 12 日，沪硅产业发布公告称，为积极响应国家半导体产业发展战略，加速推进公司长远发展战略规划，抢抓半导体行业发展机遇，持续扩大公司集成电路用 300mm 硅片的生产规模，提升公司全球硅片市场占有率与竞争优势，公司拟投资建设集成电路用 300mm 硅片产能升级项目。

本项目预计总投资 132 亿元，将用于土地购置、厂房及配套设施建设、设备购置及安装等。项目建成后，公司 300mm 硅片产能将在现有基础上新增 60 万片/月，达到 120 万片/月。

#### 12) 英伟达、AMD 探索 FOPLP 封装，与日月光洽谈

据中国台湾业内人士透露，目前 FOPLP（扇出型面板级封装）正在受到人工智能（AI）芯片设计公司关注，有两家头部芯片厂商正在与 OSAT（外包封测厂商）洽谈潜在的商业机会。

消息人士称，台积电提供的 CoWoS 封装产能仍持续紧张，但日月光一直在为 FOPLP 封装技术努力。除了继续推进芯片制造工艺的微型化，半导体行业同样非常重视先进封装技术，例如在更大尺寸的基板上封装芯片。

消息人士称英伟达和 AMD 已经与 OSAT 厂商日月光联系，希望获得 FOPLP 封装产能支持。然而目前的挑战是，市面上的大多数半导体封装设备多用于晶圆级封装，除非有强烈需求，否则设备厂商不太可能投入 FOPLP 设备制造。知情人士援引一些设备供应商的表述，如果 2025 年的需求清晰可见，那么 2024 年就可能小批量生产 FOPLP 封装设备，该技术真正投入量产可能要等到 2025 年下半年或 2026 年。

## 2.2 AI 板块

### 1) Gartner 预测 2024 年全球 AI 芯片收入将增长 33%

6 月 13 日消息，Gartner 的最新预测，2024 年全球人工智能（AI）半导体总收入预计将达到 710 亿美元，较 2023 年增长 33%。

Gartner 研究副总裁 Alan Priestley 表示：“生成式 AI 目前正在推动数据中心对高性能 AI 芯片的需求。在 2024 年，服务器中所使用的 AI 加速器的总价值将达到 210 亿美元，到 2028 年将增至 330 亿美元。”

Gartner 预测到 2024 年，AI PC 的出货量将占到 PC 总出货量的 22%；到 2026 年末，AI PC 在企业 PC 采购中的占比将达到 100%。AI PC 中的神经处理单元（NPU）能够延长其运行时间，降低运行噪声和温度，并在后台持续运行 AI 任务。这为 AI 在日常活动中的应用带来了新的可能性。

### 2) 苹果 WWDC：AI 功能亮相、Siri 整合 ChatGPT、Vision Pro 月底向部分国家销售

苹果全球开发者大会（WWDC）于台湾时间周二（11 日）凌晨一点登场，除一连串的设备系统升级消息外，万众瞩目的人工智能（AI）功能「Apple Intelligence」也亮相，其功能包含生成文本、图片等。

值得注意的是，苹果也揭晓与 OpenAI 的合作，新版 Siri 支援 ChatGPT-4o。此外，苹果还宣布 Vision Pro 本月底开始将在美国以外的部分国家销售。

### 3) 2028 年中国 AI PC 出货量将激增 60 倍

市场研究机构 IDC 数据指出，随着算力和大模型平台的进一步加强，AI PC 不断进化，下一代 AIPC 也崭露头角，预计到 2028 年中国下一代 AI PC 年出货量将是 2024 年的 60 倍。

2024 年是 AI PC 发展的元年，上半年不论是芯片端还是 PC 厂商都在 AIPC 市场快速布局，相关的大模型，生态以及交互也都在发生着日新月异的变化。IDC 指出，随着端侧算力的不断加强，端侧模型也可以为 PC 用户带来较好的 AI 功能体验，相比于云端来讲，端侧模型具备较高的安全性和及时性，是下一代 AI PC 必不可少的部分。而云侧模型则可以提供更为丰富的功能和算力，未来端云结合将是 AI PC 长期的发展方向。

## 2.3 消费电子板块

### 1) 2024 年全球笔记本电脑将出货 1.7 亿台，Arm 架构渗透率有望超 20%

研究机构 TrendForce 集邦咨询最新报告指出，2024 年全球笔记本电脑出货量仍

受到地缘因素与高利率抑制市场动能的影响，预计全年出货量将达到 1.7345 亿台，较 2023 年增长 3.6%。具备人工智能（AI）的笔记本电脑方面，严谨符合 AI PC 规范的笔记本新品将于下半年陆续推出，初代机型售价预计在 1099~1699 美元之间，定价略高，因此预计 2024 年 AI 笔记本渗透率约为 1%左右。

不过，该机构乐观预计 2025 年 AI 笔记本表现，预计渗透率将快速增长至 20.4%。随着更多制造商推出搭载 AI 芯片和高级功能的笔记本电脑，此类产品普及率预计将在未来几年持续攀升。

## 2) 苹果 2026 年或推可折叠 iPhone 采用外折设计

海通国际分析师 Jeff Pu 近日透露，苹果将在 2026 年推出可折叠智能手机 iPhone，据称该手机采用“外折设计”，展开后屏幕尺寸为 7.9 英寸。

即当设备折叠起来时，显示屏将位于外面。与完全折叠相比，由于屏幕在设备周围的弯曲半径更大，因此这可以帮助屏幕更不容易因折痕而损坏。同时，由于屏幕暴露在封闭设备的两侧，因此它也更容易出现划痕和磨损。

同时 Jeff Pu 透露，苹果还在开发一款 20.3 英寸可折叠 MacBook，这款设备可能与 ThinkPad X1 Fold 类似，采用内折设计，预计 2025 年量产。

## 3) Q2 折叠屏手机面板出货量将创历史新高，翻倍至 925 万片

研究机构 Counterpoint 旗下 DSCC 近日公布报告显示，2024 年第一季度折叠屏智能手机面板出货量同比增长 46%，至 394 万片；华为以历史最高水平的 55% 主导面板采购，并连续第二个季度位居榜首。第一季度共计 24 款不同的折叠屏智能手机型号进行了面板采购。

预计第二季度折叠屏智能手机面板出货量将同比增长 113%，至创纪录的 925 万片，原因是三星比去年提前一个月采购/生产其最新的 Galaxy Z Flip6/Z Fold6 面板，并且华为的面板采购量随着新机型和中国强劲的需求而继续增长。预计三星即将发布的两款折叠屏新机，将成为第二季度面板采购量排名前二的机型。

## 4) Q1 中国 AR/VR 头显出货量下滑 37.8%，下半年或迎转机

IDC 最新发布的报告显示，2024 年第一季度中国 AR/VR 头显出货 10.7 万台，同比 2023 年下滑 37.8%。其中 AR（增强现实）出货 0.8 万台，同比上涨 119.2%；ER（扩展现实）出货 4.4 万台，同比上涨 136.2%；MR（混合现实）出货 3.4 万台，同比下滑 52.7%；VR（虚拟现实）出货 2.2 万台，同比下滑 72.6%。

IDC 预测，2024 年下半年，国内 VR&MR 中高端线将加速发展。苹果 Vision Pro 将在 6 月底进入中国市场，预计主要布局于商用中高端商用教育市场，届时将推动国内 MR&VR 厂商在中高端线的布局和发展，加剧厂商间的竞争。

## 2.4 汽车电子板块

### 1) 中国新能源乘用车市场规模将在 2028 年突破两千万大关

6 月 12 日消息, IDC 今日发布预测报告, 中国乘用车市场中, 新能源车市场规模将在 2028 年超过 2,300 万辆, 年复合增长率 (CAGR) 为 22.8%。

报告称, 随着以比亚迪为首的新能源品牌对产品的布局在更加广泛的价位段全面铺开, 以及小米、智界等品牌的强势入局, 中国乘用车市场电动化、智能化的进程继续稳定推进。

报告提到, 随着新能源车的发展进入稳定增长阶段, 2024 年一季度中国乘用车市场中, 新能源车在新车中的占比与 2023 年同期相比继续呈上升态势。新能源车在乘用车市场的突破主要集中于入门级 (10 万人民币左右) 与中高端 (30 万元人民币左右) 两个价位段。

### 2) 中汽协: 5 月销售新车 241.7 万辆, 出口同比增长 23.9%

6 月 12 日, 中汽协发布 5 月汽车工业产销报告称, 5 月, 汽车产销分别完成 237.2 万辆和 241.7 万辆, 产量环比下降 1.4%, 销量环比增长 2.5%, 同比分别增长 1.7% 和 1.5%。1-5 月, 汽车产销分别完成 1138.4 万辆和 1149.6 万辆, 同比分别增长 6.5% 和 8.3%。

5 月, 新能源汽车产销分别完成 94 万辆和 95.5 万辆, 同比分别增长 31.9% 和 33.3%, 市场占有率达到 39.5%。1-5 月, 新能源汽车产销分别完成 392.6 万辆和 389.5 万辆, 同比分别增长 30.7% 和 32.5%, 市场占有率达到 33.9%。

### 3) 5 月动力电池装车量 39.9GWh, 同比增长 41.2%

6 月 14 日, 中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示, 5 月动力电池装车量 39.9GWh, 按年增长 41.2%, 按月增长 12.6%。其中三元电池装车量 10.4GWh, 占总装车量 26%, 按年增长 14.7%, 按月增长 4.3%; 磷酸铁锂电池装车量 29.5GWh, 占总装车量 74%, 按年增长 54.1%, 按月增长 15.8%。

1 月至 5 月, 动力电池累计装车量 160.5GWh, 累计按年增长 34.6%。

## 2.5 面板板块

### 1) 京东方 A: 受益大型体育赛事, TV 面板出货量和面积有望双增长

6 月 12 日, 京东方 A 在披露的投资者关系活动记录表中表示, 2023 年终端市场整体疲弱, 五大传统应用终端销量下降, 下半年随消费电子旺季到来, 终端市场有所回暖。2023 年全年, 受 TV 大尺寸化加速恢复影响, TV 面板出货面积保持稳定。2024 年受益于大型体育赛事的召开, TV 终端及面板需求恢复有望加速, 尤其是在 TV 大尺

寸化趋势延续的背景下，TV 面板出货量和面积有望实现双增长。

产品价格方面，根据咨询机构数据及分析，5 月 LCD TV 面板价格涨幅出现收窄，6 月份维持高位。IT 类产品价格回升态势开始初步显现，其中桌面显示器类产品自 3 月份起部分尺寸产品价格上涨，5 月涨幅扩大，6 月涨幅有所收窄；笔记本电脑类产品自 4 月下旬起部分尺寸产品价格小幅上涨。

稼动率方面，3 月、4 月因下游品牌厂备货需求旺盛，LCD 稼动率尤其是 TV 稼动率保持较高水平；随着阶段性备货需求下降，5 月 LCD 行业稼动率有小幅下降。考虑到三季度即将进入到行业传统旺季，下游品牌厂商仍有望进一步释放备货需求。

## 2) 三星显示公布 LEDoS 开发技术，瞄准 AR 设备市场

三星显示 (SDC) 公布了用于增强现实 (AR) 设备显示器的硅基 LED (LEDoS) 技术的前景，预计 LEDoS 技术将从“蓝色+量子点 (QD)”方法发展到“RGB 3-panel”和“Monolithic 1-panel”方法。

三星显示副总裁 Huh Jong-moo 在微型显示器会议上介绍了各种 LEDoS 技术。LEDoS 最大的特点是用硅基板代替玻璃基板，将无机材料 (LED) 沉积在硅基板上以形成 Micro LED。

事实上，自 2022 年底以来，三星显示就设定了以“M 项目”为名开发“1 英寸左右的微型显示器”的目标。目前，除了 LEDoS 之外，硅基有机发光二极管 (OLEDoS) 技术也是一项标志性的微型显示器技术。

## 三、 公司动态跟踪

图表 9：过去一周股东增减持更新

证券代码	证券简称	公告日期	方向	股东名称	股东身份	拟变动数量上限	拟变动数量上限占总股本比 (%)
603685.SH	晨丰科技	2024-06-13	减持	杭州重湖私募基金管理有限公司	5%以上非第一大股东	2,535,082.00	1.50
688683.SH	莱尔科技	2024-06-13	增持	范小平	董事长		
688683.SH	莱尔科技	2024-06-13	增持	龚伟全	董事兼副总经理		
603933.SH	容能科技	2024-06-12	增持	赵健民	董事,副总经理	50,000.00	
688381.SH	帝奥微	2024-06-15	减持	江苏润友投资集团有限公司	5%以上非第一大股东	2,522,000.00	1.00
600898.SH	*ST 美讯	2024-06-12	增持	国美信科技有限公司	控股股东关联方		
300936.SZ	中英科技	2024-06-13	减持	顾书春	董事,副总经理	59,075.00	0.08
301379.SZ	天山电子	2024-06-13	减持	李小勇,深圳市中金蓝海资产管理 管理有限公司	持股 5%以上股东及其一 致行动人		2.00
002952.SZ	亚世光电	2024-06-14	减持	边瑞群	股东兼公司董事,高级管 理人员	1,600,000.00	0.99

688372.SH	伟测科技	2024-06-12	减持	苏民投君信(上海)产业升级与 科技创新股权投资合伙企业	5%以上非第一大股东	340,000.00	0.30
688048.SH	长光华芯	2024-06-12	减持	谭少阳	董事,监事,高级管理人员	26,260.00	0.01
688048.SH	长光华芯	2024-06-12	减持	张玉国	董事,监事,高级管理人员	65,000.00	0.04
688260.SH	昀冢科技	2024-06-13	增持	董事,监事,高级管理人员	董事,监事,高级管理人员		
605277.SH	新亚电子	2024-06-15	减持	海南历信创业投资合伙企业	5%以下股东	9,521,710.00	3.00
688512.SH	慧智微-U	2024-06-12	减持	GZPAHoldingLimited	股东	3,049,866.00	0.67
688512.SH	慧智微-U	2024-06-12	减持	珠海广发信德智能创新升级 股权投资基金	股东	689,270.00	0.15
688512.SH	慧智微-U	2024-06-12	减持	珠海广发信德科文创业投资 基金	股东	609,973.00	0.13
688512.SH	慧智微-U	2024-06-12	减持	广州南鑫珠海港股权投资合 伙企业	股东	609,973.00	0.13
688512.SH	慧智微-U	2024-06-12	减持	珠海广发信德环保产业投资 基金合伙企业	股东	609,973.00	0.13
688512.SH	慧智微-U	2024-06-12	减持	广州信德创业营股权投资合 伙企业	股东	406,649.00	0.09
688512.SH	慧智微-U	2024-06-12	减持	广远众合(珠海)投资企业	股东	124,028.00	0.03
300303.SZ	聚飞光电	2024-06-12	减持	周丽丽	董事	59,400.00	0.00

数据来源: Wind, 华福证券研究所

图表 10: 过去一周股权激励一览

代码	名称	公告日期	方案进度	激励方式	激励总数 (万)	激励总数占当时 总股本比例(%)	期权初 始行权 价格
688045.SH	必易微	2024-06-15	实施	上市公司定向发行股票及上市 公司提取激励基金买入流通股	86.00	1.2455	15.00
688210.SH	统联精密	2024-06-13	实施	上市公司定向发行股票及上市 公司提取激励基金买入流通股	471.31	2.9730	10.70
003019.SZ	宸展光电	2024-06-14	实施	上市公司定向发行股票及上市 公司提取激励基金买入流通股	771.12	4.4972	8.16
603228.SH	景旺电子	2024-06-15	实施	上市公司定向发行股票及上市 公司提取激励基金买入流通股	1,484.11	1.7629	9.39
603228.SH	景旺电子	2024-06-15	实施	上市公司定向发行股票及上市 公司提取激励基金买入流通股	755.79	0.8977	15.32
688045.SH	必易微	2024-06-15	实施	上市公司定向发行股票及上市 公司提取激励基金买入流通股	86.00	1.2455	15.00
688210.SH	统联精密	2024-06-13	实施	上市公司定向发行股票及上市 公司提取激励基金买入流通股	471.31	2.9730	10.70

数据来源: Wind, 华福证券研究所



#### 四、 风险提示

技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。

### 分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

### 一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

### 特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

### 投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

### 联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfyjs@hfzq.com.cn